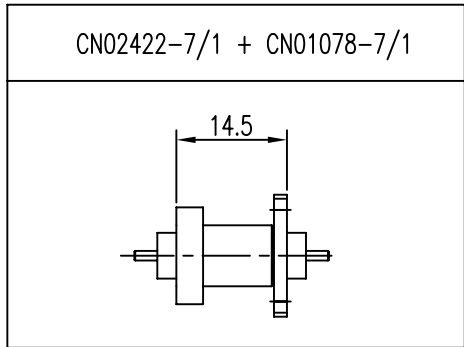
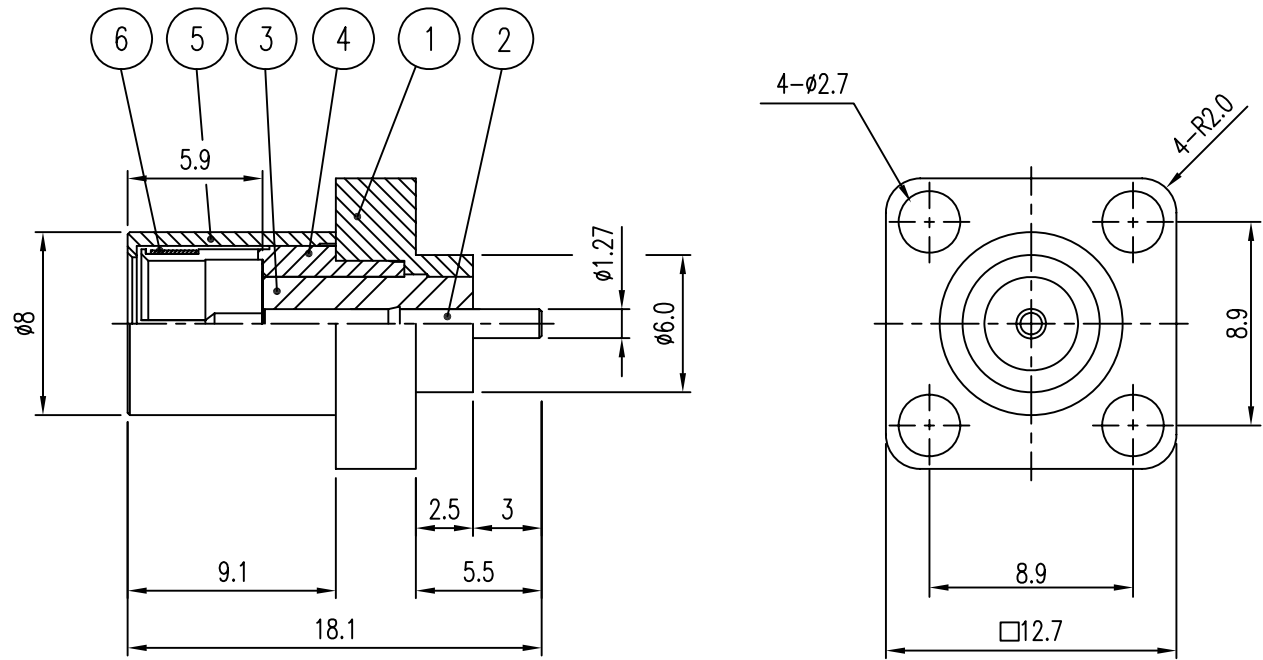


수 정 내 용									
ST	가	장							
부호	내 용						수정자	승인자	년 월 일
1	[첨변No.201810-0003] 원가절감 및 MATING 개선으로 인한 링 식재						은선영	김인철	2018. 10. 10
2	[첨변No.202006-0005] 배아당 표준화로 인한 링 재추가						은선영	김인철	2020. 06. 16



2	1	6	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00007-5/1 (R2004)
		5	CAP	1	MBsBD	무전해 Nickel Plate	DCU00139-5/1 (K2029)
		4	JACK	1	MBsBD	Nickel Plate	DJA00112-5/1 (J2009)
		3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01310-N/1 (H2386)
		2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01559-5/1 (E2576)
		1	BODY	1	MBsBD	무전해 Nickel Plate	DBD02537-5/1
		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일 2009. 7. 9.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인					
	검도					
재질		제도	도명 PDM(φ 5.5) SOLDER END P-4H			
열처리	작성부서 연 구 소			A4	도번 CN02422-7/1	
보호파막처리	적도 3/1	단위 mm	중량			

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		도명		PDM(ø 5.5) SOLDER END P-4H	
A4		도번		CN02422-7/1	